

國立勤益科技大學 人工智慧應用工程系

113 學年度 四年制產學合作海外青年

半導體製造實務技術專班學分計畫表

113 學度入學適用

112.11.08 112 學年度第一學期第 4 次系務暨課程會議通過

112.11.22 院課程會議審議通過

112.12.07 校課程會議及 112.12.21 教務會議審議通過

	第一學年						第二學年						第三學年						第四學年					
	科 目			上學期			下學期			科 目			上學期			下學期			科 目			上學期		
	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習	學分	正課	實習
必修	共 同 科 目 (24 學分)																							
	華語聽說(一)	3	5	0			華語聽說(三)	3	3	0														
	華語讀寫(一)	3	5	0			體育(三)	0	2	0														
	華語輔導課程	0	5	0			體育(四)			0	2	0												
	體育(一)	0	2	0																				
	英文聽與說(一)	3	3	0																				
	英文聽與說(二)				3	3	0																	
	華語聽說(二)				3	5	0																	
	華語讀寫(二)				3	5	0																	
	體育(二)				0	2	0																	
	微積分				3	3	0																	
	小計	9	20	0	12	18	0	小計	3	5	0	0	2	0										
	基 礎 科 目 (32 學分)																							
	專業外語(一)	3	3	0			產業製造程序實習(一)	3	0	6			產業製造程序實習(三)	3	0	6								
	人際溝通	3	3	0			產業生產設備實習(一)	3	0	6			產業生產設備實習(三)	3	0	6								
	工程實務訓練(一)	1	1	0			產業製造程序實習(二)			3	0	6												
	專業外語(二)				3	3	0	產業生產設備實習(二)			3	0	6											
	勞動法規				3	3	0																	
	工程實務訓練(二)				1	1	0																	
	小計	7	7	0	7	7	0	小計	6	0	12	6	0	12	6	0	12	0	0	0	小計	0	0	0
	專 業 科 目 (38 學分)																							
							程式設計	3	3	0			半導體元件概論	3	3	0			積體電路封測實務	3	3	0		
							電腦軟體應用與設計	3	2	2			計算機組織	2	1	2			積體電路製程實務				3	3

							工 業 4.0 概 論				3	2	1	資料結構(一)	2	1	2			機 電 整 合 實 務					3	3	0					
							數位邏輯與實習				2	1	2	資料結構(二)				2	1	2												
							基 本 電 學				3	3	0	機器學習				3	3	0												
														資料庫管理系統實務				3	2	1												
							小計				6	5	2	8	6	3		小計	7	5	4	8	6	3		小計	3	3	0	6	6	0
共 同 選 修	全民國防教育軍事訓練 (一)	1	2	0			全民國防教育軍事訓練 (三)	1	2	0				體 育 選 修	1	2	0			體 育 選 修	1	2	0									
	全民國防教育軍事訓練 (二)				1	2	0	全民國防教育軍事訓練 (四)				1	2	0	體 育 選 修				1	2	0	體 育 選 修					1	2	0			
							生 命 關 懷 實 務	3	3	0																						
	小計	1	2	0	1	2	0	小計	4	5	0	1	2	0	小計	1	2	0	1	2	0	小計	1	2	0	1	2	0				
專 業 選 修	專 業 選 修 科 目																															
							半 導 體 元 件 概 論	3	2	1				AI 實務專題 (一)	3	2	1			產學合作專題 (一)	3	2	1									
							智慧製造實務技 術	3	2	1				智慧機械 APP 設計實務	3	2	1			機器人學	3	2	1									
							積體電路封裝製 程實務(一)	3	2	1				機械與自動控 制	3	2	1			測試製程實務	3	2	1									
							VLSI 概論	3	2	1				積體電路封裝 製程實務(二)	3	2	1			封裝結構力學	3	2	1									
							半導體產品概論	3	2	1				AI 實務專題(二)				3	2	1	科 技 報 告 寫 作	3	3	0								
							智慧機械概論	3	2	1				智慧機械 SMB 實 務				3	2	1	產業產品組裝實習 (二)	6	0	12								
							科技英文	2	2	0				覆晶技術製程 實務				3	2	1	產學合作專題 (二)					3	2	1				
							半導體製程概論				3	2	1	AOI 工程應用實 務				3	2	1	積體電路封裝 製程實務(三)					3	2	1				
							電子電路概論				3	2	1	凸塊技術製程 實務				3	2	1	工業機械手臂實 務					3	2	1				
							電 腦 輔 助 繪 圖				3	2	1	生 涯 規 劃				3	3	0	AI 產業應用實 務					3	2	1				
															產業產品組裝實習 (一)				6	0	12	半 導 體 元 件					3	2	1			
																				產業產品組裝實習 (三)					6	0	12					
必修科目學分/ 時數		16	27	0	19	25	0	必修科目學分/ 時數		15	10	26	14	8	27	必修科目學分/ 時數		13	5	28	8	6	3	必修科目學分/ 時數		3	3	0	6	6	0	
備 註		1. 畢業至少應修滿 128 學分【必修 94 學分，選修至少 34 學分(其中至少需含本系專業必修科目 30 學分)】。 2. 學生須於一年級第二學期結束前通過「華語文能力測驗 A2 級」，未通過者須於認證僑華校學習華語 240 小時，未達者逕予退學。(112 學年度四年制產學合作學士暨二年制副學士海青班分發研商會議紀錄 112.07.19)																														